证券代码：301041　　证券简称：金百泽

深圳市金百泽电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☑业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参加公司2025年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026年05月25日 15:00-16:30
地点	价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 武守坤 独立董事 罗润华 财务总监 王娟
投资者关系活动主要内容介绍	**1. 1董事长能否学习迅捷兴，反复强调：我们金百泽未来All in AI，一切资源向AI算力服务器与AI机器人倾斜。 2.现PCB业务有哪些知名的企业客户？在算力服务器方面，今年开拓了哪些大的新客户？ 3.战略方向上：我们的标杆（学习）企业是谁？我们为此做了些什么布局？** 答:（1）尊敬的投资者您好！公司将继续坚持“AI+制造+服务”核心模式，聚焦PCB与IPDM双核心主业，围绕人工智能、数据中心、具身智能、人形机器人、低空经济、电力工控、医疗电子、航空航天等重点方向，持续推进业务拓展和能力建设。公司PCB业务持续向

	算力服务器、高速光模块、高阶HDI等方向延伸，并在具身机器人、无人机、电力能源等领域持续推进客户拓展和产品能力建设；同时，依托IPDM一站式服务能力、中试平台及造物数科平台建设，持续提升从研发设计、工程验证到试产量产的综合服务能力。 围绕主业发展需要，公司也持续推动AI与数字化工具链融合，重点在研发设计、工程管理、制造协同等环节开展能力建设和场景应用。造物数科正逐步将工艺知识、设计规范、失效案例和质量标准沉淀为可复用的工程规则库、AI模型及场景化工具，并在设计审查、Gerber解析、BOM分析、器件优选等环节为工程人员提供支持，进一步提升研发效率和工程协同水平。 公司看好AI算力服务器和机器人等方向带来的产业机会，也会结合市场发展、客户需求和自身能力基础，持续加强相关业务布局和能力建设。公司聚焦主业，重视立足电子互连及封装主业，把相关新兴领域需求转化为PCB、IPDM、工程服务、数字化平台和中试服务等实际业务机会，稳步推动相关布局转化为长期经营成果。相关经营情况请以公司在法定信息披露媒体披露的定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的关注！ （2）公司PCB业务持续向人工智能、数据中心、通信、电力、工控、汽车、医疗、低空经济等领域延伸，产品结构持续向服务器主板、算力卡、高速光模块、高阶HDI等高附加值方向升级，并围绕高价值客户和高价值赛道持续推进市场拓展和能力建设。公司长期聚焦PCB样板、小批量、特色板以及IPDM集成设计与制造服务，更多服务于客户研发、中试、工程化和小批量制造阶段。 公司持续跟踪算力服务器等相关产业领域需求，围绕相关产品和客户合作持续推进市场拓展与能力建设，已有相关产品交付，但现阶段相关订单金额较小，对公司整体业务和经营业绩影响有限。基于商业保密及信息披露公平原则，公司不便披露具体客户名称、具体新客户导入情况及项目进展。公司将继续坚持“AI+服务+平台”的业务发展策略，持续强化工程服务能力、快速交付能力和一站式服务能力，推动相关业务稳步拓展。相关经营情况请以公司在法定信息披露媒体披露的定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的关注！

	（3）公司战略方向始终坚持从自身实际出发，立足深耕三十年电子电路的互连及封装技术优势，围绕服务数万家客户硬件创新的know-how和工业数据，持续完善“AI+制造+服务”核心模式。公司长期关注行业内优秀企业在高端制造、设计与工程服务、工业智能体、数字化平台、国际化经营和产业协同等方面的先进做法，并结合自身定位、客户需求和业务发展阶段，持续进行学习、借鉴和优化提升。 围绕战略方向，公司已持续推进多项布局：一是夯实PCB与IPDM双核心主业，强化高多层、高可靠性及高附加值产品能力建设；二是推进造物数科与华为战略合作“云设计、云工程、云工厂”等平台建设，以工业智能体提升研发、工程、制造和交付协同能力；三是围绕中试平台、科创服务、人才培养和产业生态持续完善支撑体系；四是以香港和新加坡科创中心为基地等推动金百泽科创服务国际化布局，探索“本地化服务+国内能力支撑+平台化协同”的出海路径。感谢您对公司的关注。 **2.尊敬的董事长，您好，请问贵公司与富士康合作进展如何，谢谢！** 答:尊敬的投资者您好！公司与富士康的合作主要通过杭州佰富物联开展。佰富物联作为集团与工业富联合作设立的子公司，主要围绕集成产品制造IPM、工业互联网及科创服务相关业务进行开拓，服务于公司整体业务协同和能力建设。 从目前情况看，公司与工业富联合作仍在围绕业务协同、客户拓展和能力建设等方面持续推进，现阶段整体规模仍较小，对公司整体经营业绩影响有限，后续业务发展仍需结合市场需求、客户导入及项目落地情况逐步推进。相关经营情况请以公司在法定信息披露媒体披露的定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的关注。 **3.尊敬的董事长您好，请问贵公司还有子公司造物数科和佰富物联有向华为或英伟达送样，或是直接还是间接供货吗？公司在北美的长期稳定客户是哪些？谢谢！** 答:尊敬的投资者您好！造物数科聚焦电子信息领域产业互联网运营、数字化服务和平台能力建设，佰富物联主要围绕集成产品制造IPM、工业互联网及科创服务相关业务开展布局，均服务于公司整体业务协同和能力建设。截至目前，英伟达并非公司客户，不存在

	直接销售收入。公司以英伟达Jetson系列构建云边端一体的算力底座，基于自研评估板持续迭代，面向相关场景提供先进硬件与行业化解决方案。公司PCB及IPDM业务持续向人工智能、数据中心、通信等领域延伸，并围绕算力服务器、高速光模块、高阶HDI等方向持续推进市场拓展和产品能力建设。 公司持续推进北美国际化布局，积极探索本地化服务与国内制造、工程能力协同联动的出海模式。基于商业保密及信息披露公平原则，公司不便披露具体境外客户名称。相关经营情况请以公司在法定信息披露媒体披露的定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的关注。 **4.尊敬的董事长您好，请问贵公司在CPO、光模块上，有何布局，谢谢！** 答:尊敬的投资者您好！公司专注电子互连及封装技术，聚焦PCB、IPDM及相关中试与工程服务能力建设，PCB业务持续向人工智能、数据中心、通信等领域延伸，并围绕高多层、高可靠性、高速高密度等方向持续推进产品能力建设。公司相关产品已覆盖800G高速光模块、数据中心高速板等方向，并具备高阶HDI、高速板等相关技术与产品基础。 在具体布局上公司结合客户研发需求，具备提供相关PCB样板、小批量制造及配套工程服务的能力，持续进行光模块相关市场拓展和技术储备。对于CPO等前沿方向，公司保持持续关注，并将结合客户需求、技术演进和自身能力基础稳步推进相关布局。现阶段，相关业务整体规模较小，对公司整体收入和经营业绩影响有限，未来仍受客户导入、技术迭代及市场需求变化等因素影响，存在一定不确定性。相关经营情况请以公司在法定信息披露媒体披露的定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的关注。 **5.尊敬的董事长您好，请问贵公司在半导体，存储器，存储芯片上，有何布局，谢谢！** 答:尊敬的投资者您好！公司专注电子互连及封装技术，聚焦PCB、IPDM及相关中试与工程服务能力建设，业务覆盖人工智能、信息技术、工业控制、汽车电子、医疗设备等领域。公司并不直接从事半导体、存储器或存储芯片的设计制造业务，相关布局主要是依托电子互连、封装基板、PCB设计、仿真分析、样板及小批量制造等

	能力，为客户研发、中试和工程化阶段提供配套服务。 在上述方向上，公司持续推进封装载板等高端特色产品的技术研发和产品能力建设，并开展存储、射频等芯片封装基板、多层超高密度互连类载板等的技术研究和产品开发，已实现样板和小批量交付。相关能力可应用于半导体及高速通信等产业链相关环节，但现阶段处于产品研发迭代和客户拓展阶段，目前对公司整体收入和经营业绩影响较小。 未来，公司将结合客户需求、技术演进和自身工程制造基础，持续推进相关高端特色产品和配套服务能力建设，积极把握产业升级带来的业务机会。相关经营情况请以公司在法定信息披露媒体披露的定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的关注。 **6.尊敬的董事长您好，请问贵公司在商业航天，人形机器人方面有何布局，谢谢！** 答:尊敬的投资者您好！公司专注电子互连及封装技术，聚焦印制电路板PCB、集成产品设计与制造IPDM，同时提供产品加速中试平台、投资孵化、职业教育、数字科技、科创服务等业务。公司坚持“专行业，精产品”技术服务路线，对商业航天领域包括但不限于遥测、卫星和通信等对端侧算力、3D封装、减重等的共性技术研发，持续围绕高可靠性、高端特色解决方案方向开展业务拓展。 公司PCB及IPDM业务聚焦电子互连和封装，服务具身智能和人形机器人、电力能源等端侧算力的相关应用方向。公司在具身智能和人形机器人等领域持续服务相关客户，与广大工程师交流，依托自身集成产品设计与制造能力，提供高集成、高可靠的IPDM集成设计与制造解决方案，覆盖从电源动力、通信传输、感知采集、执行驱动到控制运算的全链条环节，助力客户打通从研发到量产的工程化关键环节，夯实核心硬件底座。感谢您对公司的关注。 **7.请武总，公司常年营收和利润都较低，管理层有没有反思公司的定位？大批量生产是否更有可能获得大的订单，同时获取更大利润？** 答:尊敬的投资者您好！公司管理层持续关注经营质量、业务模式和规模化路径。2025年，公司实现营业收入7.01亿元，同比增长2.62%；归属于上市公司股东的净利润2,016.07万元，同比下降

	48.39%。利润阶段性承压，主要受市场竞争加剧、下游需求恢复节奏分化、关键原材料价格上涨，以及公司围绕PCB、IPDM、数字化平台和科创服务等方向持续推进高价值赛道布局、平台建设、工程系统升级和供应链能力建设，相关投入具有一定前置性和培育周期等因素综合影响。 与部分以大批量产能驱动为主的企业不同，公司长期聚焦PCB样板、小批量、特色板以及IPDM一站式服务，更多服务于客户研发、中试、工程化和小批量制造阶段，这一模式在客户粘性、工程服务和高附加值能力建设方面具有自身特点。同时，公司也在积极探索和布局大规模、高价值产品方向，始终坚持“前瞻明日技术，致力今日实现”的理念，围绕高技术、高可靠、快速交付方向持续进行技术攻关和产能建设。2026年一季度，公司营业收入同比增长15.70%，亏损同比明显收窄，经营情况呈现边际改善态势。 公司将继续坚持“AI+服务+平台”核心模式，聚焦PCB与IPDM双核心主业，持续提升高附加值产品能力和系统解决方案能力。IPDM未来有望实现规模化复制，关键在于行业解决方案沉淀、工程数据标准化、供应链协同和项目管理能力。公司正依托造物数科及相关数字化平台，推进云设计、云工程、云工厂等能力建设，并推动AI与智能体在工程审阅、BOM分析、报价评估、制造协同、交付管理等环节落地应用，提升业务协同和交付效率；同时，通过订单标签标准化、一站式业务成本模型、分级报价策略、价值客户管理、订单产能交付闭环、集成交付管理等方式，持续增强可复制能力，推动公司由“模式成型”向“规模兑现”加快转化。感谢您对公司的关注！ **8.请问贵公司，在pcb板块从启动到现在翻了两三倍的背景下，贵公司的股票基本都是横盘震荡，是什么经营方面的原因形成不被主流资金看好吗？** 答:尊敬的投资者您好！二级市场股价波动受多重因素影响，公司管理层将围绕“AI+制造+服务”核心发展模式，坚持稳健技术经营，强化数字化平台服务能力，拓展集成供应链规模，努力提升公司综合竞争力。公司高度重视全体股东权益，后续将持续夯实经营业绩，强化市场沟通，持续关注资本市场动态及公司股价表现，努力提升投资者回报，切实维护全体股东的长远利益。感谢您的关注。

	9.2025年公司收入增长但利润明显下滑，投资者应如何理解“收入增长、利润承压”的情况？ 答:尊敬的投资者您好！2025年，公司实现营业收入7.01亿元，同比增长2.62%；归属于上市公司股东的净利润2,016.07万元，同比下降48.39%。报告期内，公司营业收入保持稳步增长，主要得益于公司深入践行“专行业、精产品、大客户”业务发展策略，在总体消费需求承压背景下，积极开展人工智能、无人机、新能源、电力、汽车电子智能硬件和电子物料国产替代市场的业务拓展和研发创新，其中工业控制、汽车电子、医疗电子等领域取得一定增长。 报告期利润承压主要受市场竞争加剧、下游需求恢复节奏分化、关键原材料价格上涨，以及公司围绕PCB、IPDM、数字化平台和科创服务等方向持续推进高价值赛道布局、平台建设、工程系统升级和供应链能力建设，相关投入具有一定前置性和培育周期等因素综合影响。公司当前仍处于业务模式迁移和能力升级的关键阶段，部分投入短期内尚未直接转化为利润贡献，对报告期内经营业绩形成一定阶段性压力。 公司将继续坚持“制造+服务+平台”核心模式，聚焦PCB与IPDM双核心主业，持续强化高多层、高可靠性及高附加值产品能力建设，推动设计、工程、制造、供应链协同发展，并围绕AI硬件、具身智能、人形机器人、低空经济、电力工控、医疗电子、航空航天等重点方向提升系统解决方案能力和工程化落地能力。同时，公司将持续推进数字化战略、科创引领和国际化布局，推动前期能力建设逐步转化为经营成果。感谢您对公司的关注。 **10.2026年一季度亏损明显收窄，是否可以判断公司已经进入业绩拐点？** 答:尊敬的投资者您好！2026年一季度，公司营业收入同比增长15.70%，归属于上市公司股东的净利润为-17.90万元，较上年亏损同比收窄92.63%，经营情况呈现边际改善态势。业绩边际改善一方面得益于公司持续聚焦PCB与IPDM双核心主业，围绕高价值客户、高附加值产品和一站式解决方案能力建设持续推进，推动订单质量、产品结构和交付协同能力逐步优化；另一方面，公司持续强化“AI+制造+服务”核心模式，在工程能力、数字化运营、供应链协同及高端特色产品方向的前期投入，正逐步对经营效率和业务拓展形成支撑。

	经营提升是一个持续积累和逐步兑现的过程，未来经营情况仍受行业景气度、客户导入进度、产品结构优化、原材料价格、汇率波动及新业务投入转化节奏等多种因素影响。公司将继续聚焦主业，推动高端产品、一站式服务和数字化能力进一步转化为经营成果，并严格按照规定履行信息披露义务，相关经营情况请以公司在法定信息披露媒体披露的定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的关注。 **11.公司经营活动现金流大幅改善，能否说明公司经营质量在改善？** 答:尊敬的投资者您好！2025年，公司经营活动产生的现金流量净额为8,755.56万元，同比增长84.27%，主要系报告期内销售回款同比增加、采购付款同比减少等因素综合影响。现金流改善体现了公司在客户信用管理、回款节奏、采购付款安排和营运资金管理等方面持续加强，也说明公司在利润阶段性承压的情况下仍保持了较好的经营韧性。 公司一直重视现金流安全和经营质量建设，持续完善应收账款管理机制，通过事前审核、事中监控和事后清收做好信用风险管控。后续公司将在业务拓展与风险控制之间保持平衡，继续优化客户结构、提升回款质量、加强库存和供应链管理，努力实现收入增长、利润改善和现金流安全的协同。感谢您对公司的关注。 **12.公司间接参股上海逍遥光电科技有限公司的主营业务是什么？** 答:尊敬的投资者您好！公司围绕电子互连及封装主业，依托科创服务、中试平台和产业资本协同，持续推进“技术链—产业链—人才链—资本链”融合发展。公司相关投资布局主要服务于主业延伸、产业协同和科技成果转化，重点围绕电子信息、硬件创新及相关产业生态开展前瞻性布局。 公司通过参投四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）形成对上海逍遥光电科技有限公司的间接投资。该企业主要从事电子/光电子芯片设计自动化（EDA/PDA）软件工具研发与服务，主要服务于特色工艺半导体芯片设计等环节，属于产业链上游的EDA基础工具领域，与公司围绕电子信息产业链关键环节的前

	瞻布局方向具有一定产业协同性。 整体来看，公司相关投资更侧重于围绕产业链关键环节进行前瞻布局，强化科创服务、产业协同和生态链接能力，服务于公司围绕电子互连及封装主业、科创平台和硬件创新生态的长期发展。感谢您对公司的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026年05月25日